

SONY

Sony IR Day 2018

半導体分野

2018年5月22日

ソニー株式会社 執行役員 ビジネスエグゼクティブ
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 代表取締役社長
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 代表取締役 執行役員社長

清水 照士

本日の内容

半導体分野

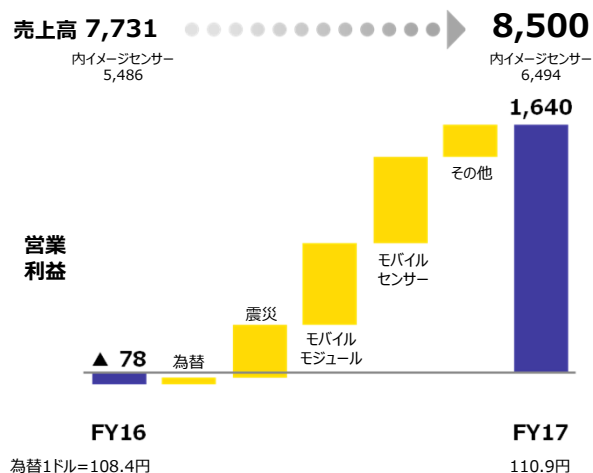
- 1. 2017年度の総括**
- 2. 2018年度の取組み**
- 3. 中期計画（2018年度～2020年度）**

1. 2017年度の総括

2017年度の総括

半導体事業として過去最高の営業利益を達成

営業利益変動要因分析 (億円)



成果

- イメージセンサーの売上・利益拡大
- 車載向けイメージセンサーの順調な顧客拡大
- 非イメージセンサー事業の収益性改善

課題

- 中国スマホ端末メーカーの需要変動への対応力
- 在庫水準の適正化
- 為替感応度の高止まり

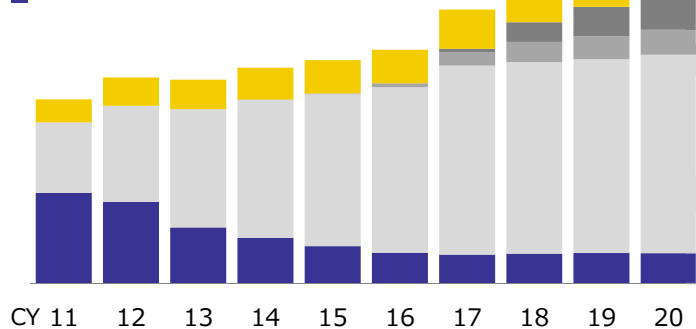
2. 2018年度の取り組み

イメージセンサー市場の見方

モバイル領域は複眼+センシング中心に拡大。新規領域の成長が期待される市場構造

WWイメージセンサ出荷金額推移イメージ

- 新規領域
- モバイルセンシング
- モバイル複眼サブ
- モバイルフロント+リア
- AV



新規領域

- ・ 車載：ADAS市場の立ち上がり
- ・ FA：製造スマート化で市場拡大
- ・ セキュリティ：AI技術を用いた自動監視普及で市場拡大

モバイル領域

- ・ 複眼+モバイルセンシング中心に市場拡大

AV領域

- ・ ハイエンドセンサー市場拡大

一眼カメラを目指した画質進化に加え、平面・時間・空間での進化を目指し感動を届ける

モバイルイメージングセンサーの進化

現在

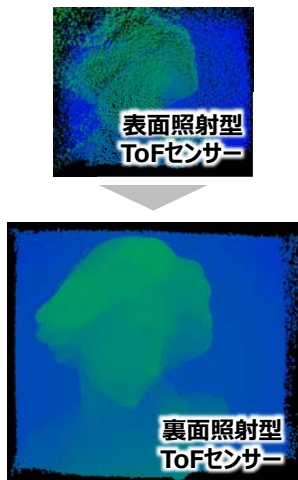
将来 ~



測距が可能な裏面照射型高精細ToF*センサー開発に成功。幅広いユースケースへの展開

ToFセンサーの開発

ToFセンサーのユースケース



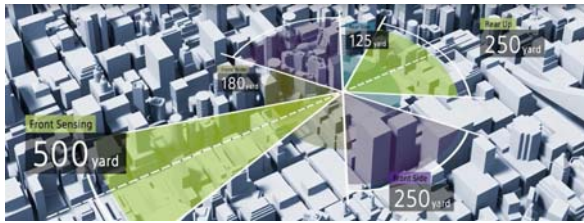
*ToF: Time of Flight

車載への取組み

半導体分野

ADAS用途の積層型イメージセンサーを商品化。キープレイヤーとの連携強化

Safety Cocoonの実現



キープレイヤーとの連携※



車載カメラ向け高解像度積層型センサーの商品化



※ロゴの並びはアルファベット順

Sony IR Day 2018

FAへの取組み

半導体分野

産業の自動化により市場は拡大。CCDからCMOSイメージセンサーへの移行進む

FA向けセンサーの進化



※GS: グローバル・シャッター

Sony IR Day 2018

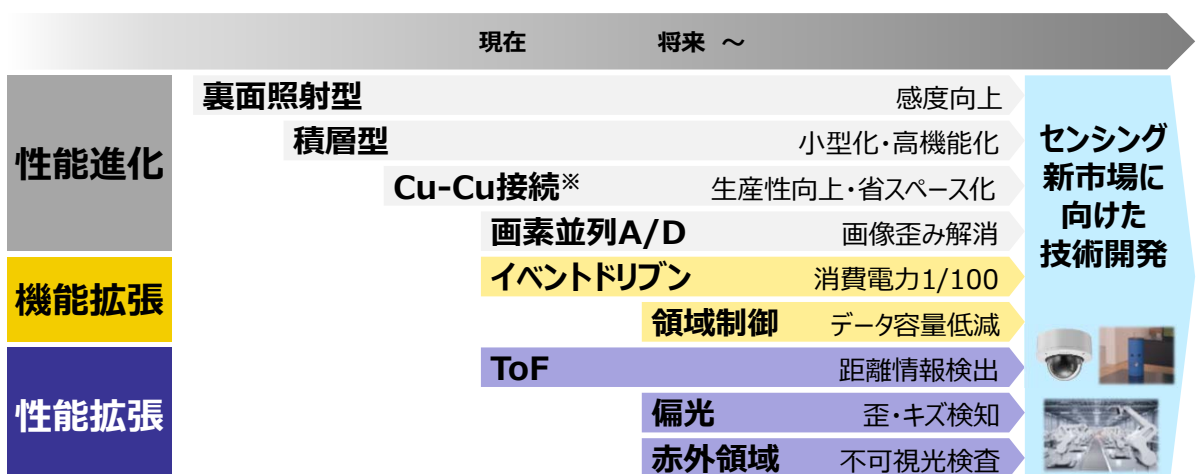
AI技術を用いた自動監視普及でセキュリティ市場は拡大

セキュリティ向けセンサーの進化



市場のニーズに対応し付加価値を生み出す技術開発を実行

技術開発の方向性



※Cu-Cu接続: カッパー・カッパー接続

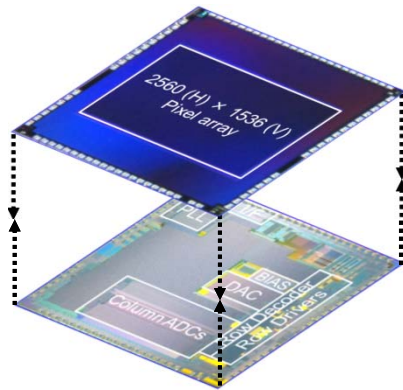
技術開発への取組み (2)

半導体分野

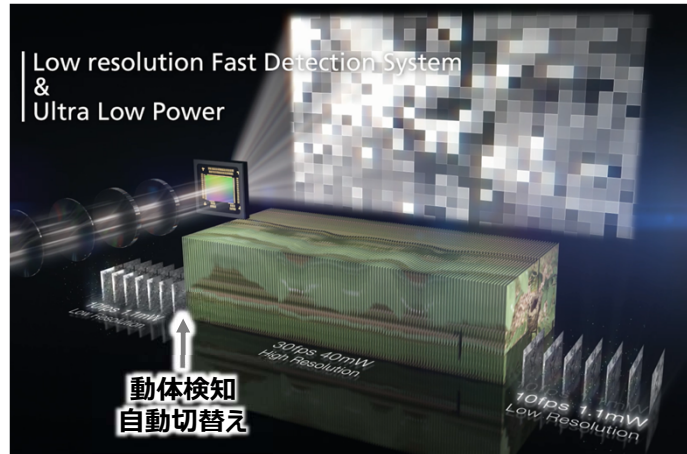
消費電力1/100を実現するイベントドリブン方式積層型CMOSイメージセンサーを開発

センサーイメージ

Cu-Cu接続による積層構造により実現



動体検知イメージ



Sony IR Day 2018

技術開発への取組み (3)

半導体分野

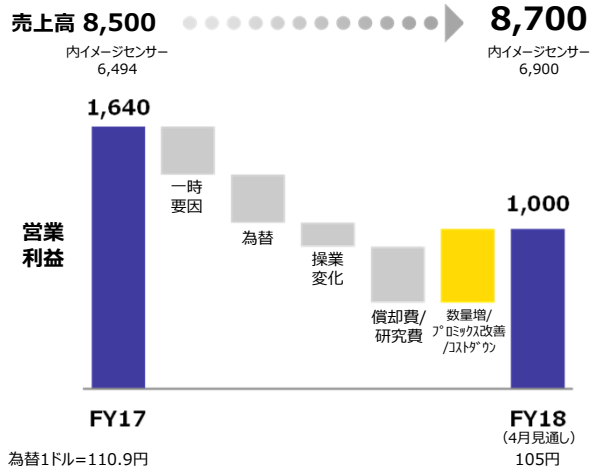
動画



Sony IR Day 2018

設備投資・R&Dを増額し「仕込み」を加速

営業利益変動要因分析 (億円)



環境

- スマートフォンの複眼化進展
- センシング・車載の立ち上がり
- 円高・スマートフォン市場の伸び悩みはリスク

基本方針

- 設備投資・R&Dを増額し「仕込み」を加速
- モバイル・AV領域を利益創出ドライバーとして収益を最大化
- センシング・車載等の新規領域を育成
- センサーの製造コスト削減活動継続

3. 中期計画 (2018年度～2020年度)

■ 2020年度 業績目標

- ◆ 営業利益 1,600億円 ~ 2,000億円
※為替1ドル = 105円前提

売上高イメージ（参考値）
11,000億円

■ 2020年度に向けた中期計画

- ◆ 環境変化への対応力を高め、モバイルセンサーの収益最大化を図る
- ◆ センシング・車載含めた新規領域の収益貢献を目指す
- ◆ 機能拡張・性能拡張を含む技術開発を推進する

SONY